

## 技術詞彙表

於本文件內，除非文義另有所指，否則本文件所用有關本公司及我們業務的若干術語的說明及釋義須具有以下所列的涵義。該等術語及其涵義未必總是與該等術語的標準行業涵義或用法相符。

術語	說明
「2G」	指 第二代，一種數字行動通訊標準，支持語音通話及有限數據傳輸
「3G」	指 第三代，一種行動通訊標準，允許手機、電腦及其他便攜式電子設備無線接入互聯網
「3D」	指 三維立體
「4G」	指 第四代，一種行動通訊標準，旨在取代3G，提供更高速的無線網路接入
「5G」	指 第五代，一種行動通訊標準，目標是較前一代4G提升至少十倍數據傳輸速度
「AI」	指 人工智能
「AMOLED」	指 主動矩陣有機發光二極體，一種以主動矩陣控制像素的顯示技術
「AOI」	指 自動光學檢測
「ATA」	指 先進技術附件
「藍牙」	指 一種短距離無線技術標準，用於固定與移動設備間短距離的數據交換
「複合年增長率」	指 複合年增長率
「CKD」	指 完全拆解件，指智能設備的完全拆解零部件，包括印刷電路板組件、顯示模組及攝像模組等硬件組件
「CPU」	指 中央處理器

## 技術詞彙表

術語	說明
「DDP」	指 完稅後交貨，賣方承擔貨物運輸相關的一切責任、風險及成本直至買方於目的港收到貨物的交付協議
「EMS」	指 電子製造服務
「FCA」	指 貨交承運人，依有關合約規定於指定地點轉移貨物所有權至買方的貿易條款
「FHD」	指 全高清
「FOB」	指 船上交貨，指賣方支付貨物至裝運港的運輸及裝載費用，買方承擔海運費、保險、目的港至最終目的地的卸貨及運輸費；及風險於貨物於裝運港裝船時轉移
「FQC」	指 最終品質控制
「千兆赫」	指 千兆赫，頻率單位
「GPS」	指 全球定位系統，美國開發的衛星導航系統，提供定位、導航及授時服務
「HD」	指 高清
「赫茲」	指 赫茲，頻率單位
「IC」	指 積體電路
「物聯網」	指 物聯網，將實體裝置、智慧設備與其他嵌入電子設備、軟件、傳感器與網絡連接的物品互聯互通，實現數據收集與交換
「IP 65」	指 國際電工委員會頒佈之《外殼防護等級代碼》中的評級，表示該產品具備完全防塵能力，並可防護任何方向的低壓水射流

## 技術詞彙表

術語	說明
「IP68」	指 國際電工委員會頒佈之《外殼防護等級代碼》中的評級，表示該產品具備完全防塵能力，並可在生產商與用戶協定的特定條件下，耐受持續性浸水防護
「IP69」	指 國際電工委員會所發布《外殼防護等級代碼》中的評級，表示該產品完全防塵及可耐受高壓高溫水柱沖射，其具體測試條件(包括水溫、水壓及噴射距離等參數)應由製造商與用戶共同協議確定
「ISO」	指 國際標準化組織，為制定包括品質管理與品質保證等國際標準之非政府組織，其標準由 Universal Certification Services Co., Ltd.等認證機構對企業組織之品質體系進行評估
「LCD」	指 液晶顯示器，一種平板顯示技術，其為透過向夾於兩片透明偏光板之間的液晶單元施加可變電壓，改變液晶材料之光學特性而運作之電子顯示裝置
「本地射頻頻段」	指 由國家或地區電信監管機構劃定的特定無線電頻率範圍，專用於特定國家或地區內，以確保無線設備符合當地標準並避免干擾
「LTE」	指 一款第四代行動通訊標準，Long-Term Evolution的縮寫，為手機與數據終端提供高速無線數據傳輸之技術標準
「mAh」	指 毫安培小時，衡量電池容量的常用電荷單位
「模組化」	指 將系統或產品劃分為獨立及標準化模組的設計原則，能夠獨立開發、替換或升級，從而提升系統靈活性，並簡化維護與客製化流程

## 技術詞彙表

術語	說明
「MiFi」	指 移動熱點裝置，能夠使多部計算機裝置共享寬帶互聯網連接
「MMI」	指 人機接口
「模組」	指 指執行特定功能之模組，可與其他模組連結構成更大規模之系統，乃由電子元件組裝至印刷電路板組件後製成
「MP」	指 百萬像素
「ODM」	指 原始設計製造
「OQC」	指 出貨品質管制
「印刷電路板」	指 印刷電路板，可提供板元件間電子連接路徑之電路載板
「印刷電路板組件」	指 印刷電路板組件，指已完成各類電子元件（如電阻、集成電路及電容等）裝配及加載軟件的印刷電路板，其具體元件配置取決於應用需求及電路板特性設計要求
「個人數碼助理」	指 個人數碼助理，一種手持式電子設備，作為數據終端機使用，能協助用戶高效採集數據並實現業務數位化管理
「平台化」	指 開發核心技術或服務平台的過程，該平台支持多種產品、應用或服務，從而在不同解決方案之間實現可重用性、擴展性及易集成性
「射頻」	指 無線電頻率
「SKD」	指 半拆解件，指手機組裝用半成品套件，包含顯示屏模組、攝像頭模組、音頻組件等可直接用於整機組裝之硬件模組
「SMT」	指 表面貼裝技術，一種將電子元件直接安裝於印刷電路板雙面的製程技術，能提升電路板承載密度、促進產品微型化，並實現高度自動化生產

---

## 技術詞彙表

---

術語	說明
「SPI」	指 焊膏檢測
「瓦」	指 瓦特，功率單位
「Wi-Fi 6E」	指 第六代Wi-Fi技術之擴展
「Wi-Fi 7」	指 最新一代的Wi-Fi技術，旨在提供顯著更高的數據傳輸速度、更低的延遲，以及更優化的網絡效率